

## 技術特色

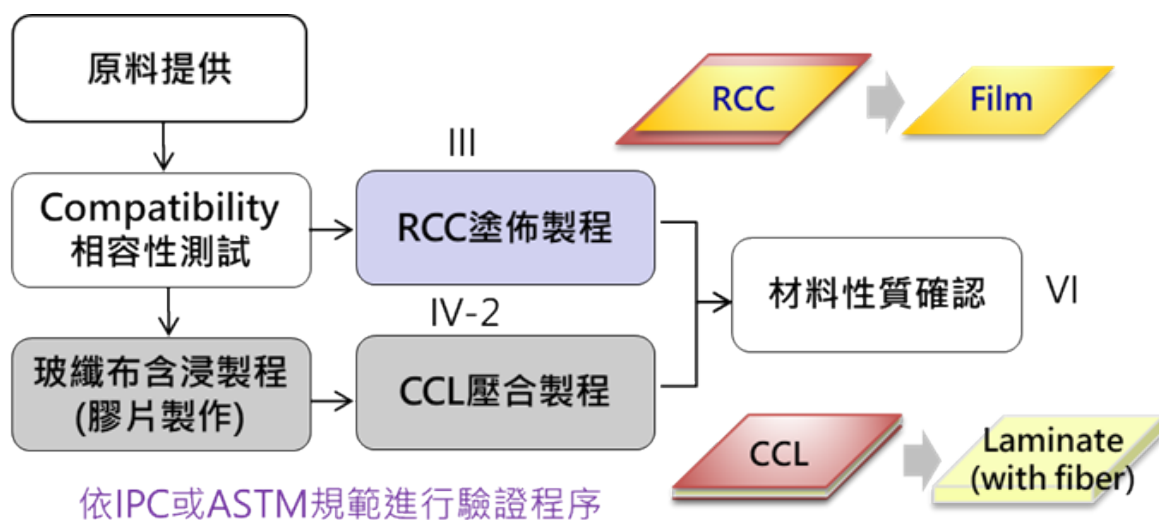
電子產品逐漸趨於輕薄短小及高功能化，促使電路板材料對高頻高速資訊的處理與大量數據傳輸出現高度需求。因此國內外廠商紛紛致力於開發低損耗銅箔基板的原料，有鑑於此，本技術建立銅箔基板暨載板材料驗證平台，可協助國內外廠商評估原料之基礎特性、加工性、於銅箔基板/載板中之物性以及應用可行性，進而提升技術能量。

驗證平台：可協助國內外廠商評估原料之基礎特性、加工性、於銅箔基板中之物性、應用可行性以及電路板可靠度測試。

可評估之原料種類：液態和固態樹脂、交聯劑、起始劑、分散劑/添加劑、耐燃劑、粉體、玻纖布、銅箔、基板、薄膜等基板材料。

## ITRI材料驗證平台

覆膠銅膜(RCC)and銅箔基板(CCL)



## 測試項目

- 電氣特性
- 化學與物理特性
- 材料應用可行性

## 原物料種類

- 樹脂/交聯劑
- Br/P 難燃劑
- 起始劑/分散劑
- Silica粉體/導熱粉體
- 玻璃纖維布
- 銅箔